



PCB LAYOUT

MICRO SIM

RoHS **HSF**

- 一、材质和镀涂:
- 1、胶芯: LCP, UL 94 V - 0, 黑色
 - 2、端子: 磷铜C5210-H, T=0.15, 镀底镀金
 - 3、外壳: 不锈钢 SUS304 T=0.2
- 二、技术参数:
- 接触电阻: 100mΩ Max
 - 绝缘阻抗: 1000MΩ Min(500DC)
 - 额定电流: 每个接触件1A Max
 - 额定电压: 30V Max(DC)
 - 耐压: 500V r.m.s/min
 - 使用温度: -40℃~85℃
 - 湿度: 90%~95%
 - 寿命: >3000次

PIN NO.	NAME	PIN NO.	NAME
C1	VCC	C4	VPP
C2	GND	C5	CLK
C3	RST	C6	I0

兆星精密电子(深圳)有限公司

E	PRODUCT SPEC.	MICRO SIM
TITLE:		翻盖式 MicroSIM卡卡座
PART NO.		ZX-MSIM-481.8J
FILE NAME:		
SCALE	1:1	UNIT:mm A4 SHEET:1 of 1

工程变更通知单号 ECN(DCN) NO.	版次 REV	日期 DATE	说明 DESCRIPTION	改变 CHANGE	承认 APPRO.	GENERAL TOLERANCE UNLESS OTHERWISE NOTED	设计 DESIGN	Lin L	230521
	B		修改实物与图纸相符			X±0.50	校阅 CHECK	Lin L	230521
	A		NEW RELEASE			.X±0.30	承认 APPRO.	Lin R	230521
						.XX±0.20			